

eCore

汎用鉛フリーやに入りはんだ

GENERAL PURPOSE

SN100C (O33) FLUX CORED SOLDER WIRE



フラックスの飛散抑制、濡れ性も向上

はんだ付けの作業性と実装後の仕上がりを高めた汎用タイプの鉛フリーやに入りはんだです。フラックス飛散の低減、ぬれ性向上、熔融速度もスピーディで、自動機を用いた連続はんだ付けにも対応。Cuに限らず、Niに対しても優れたぬれ性を発揮します。

無銀	鉛フリー	汎用品	無洗浄
フラックス飛散低減	ぬれ性良好 (赤目抑制)	ヒューム (煙) 低減	

フラックス飛散評価 各種温度範囲において、フラックス飛散を低減

■ 評価試験方法 (後盛りはんだ付工程)



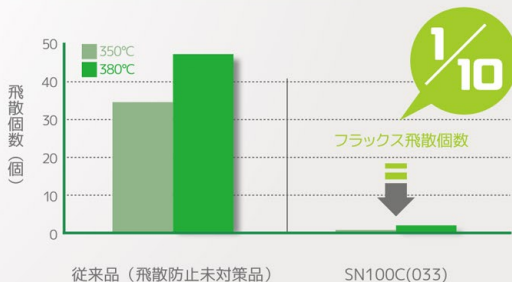
実際の評価試験の写真(左)と、試験に用いたこて先の形状(右)

【試験条件】

はんだ材料: SN100C(O33)
供給量: 6.4mm (線径φ 1.0mm)
供給速度: 20mm/s
試験数: n=5
設定温度: 350℃、380℃

フロー時のはんだ量が確保できない部品の補修として行われる「後盛りはんだ付」を想定し試験を実施。350℃、380℃において評価を行った。

■ 評価試験結果 (従来の汎用品との比較)



赤目発生比較 (ぬれ性の比較) 良好なぬれ性により赤目発生を抑制

■ 試験方法 (0.5sec / 箇所)のスピードではんだ付を30箇所行い赤目をカウント



合格

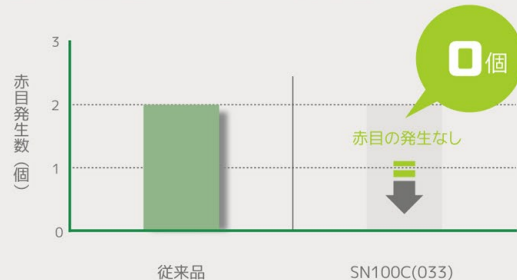


不合格 (赤目)

【試験条件】

はんだ材料: SN100C(O33)
線径: φ1.0mm
供給量: 6.4mm
供給速度: 12.8mm/s
設定温度: 380℃
評価基板: 紙フェノール基板
ランド径: 3mm

■ 赤目発生数の比較 (はんだ付箇所: 30)



※上記データ、写真は特定条件下によるものです。

